

NEWS RELEASE

平成 29 年 9 月 1 日
大王製紙株式会社

JAPAN PACK 2017

国内最大の国際総合包装展「2017 日本国際包装機械展」に出展します。

大王製紙株式会社グループのダイオーエンジニアリング株式会社は 10 月 3 日（火）より東京ビッグサイトで開催される「2017 日本国際包装機械展」に出展します。

包装ラインの「省人化・省力化のトータルコーディネート」をコンセプトとし、初出展の新型「A 式段ボールケース自動製函機」を導入した製函から封緘までのラインに加え、RFID を利用した工程管理システムの実演を行います。

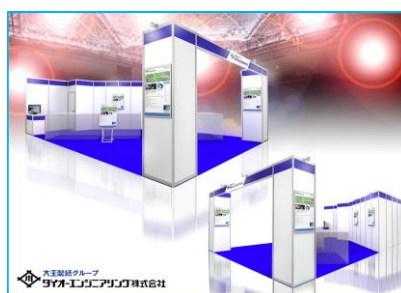
また、グループ会社のダイオーポスタルケミカル、大王パッケージの製品（ラベラー、RFID、段ボール）のご案内もいたします。

ご来場の際は、当社ブースに是非お立ち寄りください。皆様のお越しをお待ちしております。

大王製紙グループ・ダイオーエンジニアリング ブースの概要

【製品紹介】

- | | |
|---------------------|---------------|
| ・ 新型製函機 | ・ 上部封緘機(HQ-1) |
| ・ 中仕切り自動投入装置(仕切り革命) | ・ 底 H 貼り装置 |
| ・ RFID と読み取り装置 | ・ X 線検査装置 |



展示会場イメージ

出展ホール・小間番号 **東3ホール・3H-01**

2017 日本国際包装機械展の概要

- 名称 JAPAN PACK 2017 -2017 日本国際包装機械展-
Japan International Packing Machinery Show 2017
- テーマ 新しい包程式、ここに集まる。
- 会期 2017 年 10 月 3 日（火）～6 日（金） 4 日間
- 開催時間 午前 10 時～午後 5 時
- 会場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東ホール全 6 館
- 公式 HP <http://www.japanpack.jp/>